证券代码: 300842 证券简称: 帝科股份

无锡帝科电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-004

投资者关系活动类别	☑特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	□其他(电话会议)
参与单位名称	中金公司、西部利得、富	安达基金、永诚资产、丹羿投资、准
	锦投资、长江证券、君璞	咨询、国君资管等10人。
时间	2025年3月25日	
地点	上海分公司会议室	
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书: 彭民先生	
	应用技术部&市场部副总经理: 南亚雄先生	
1. 公司在高铜浆料的战略布局?		
	答:在高铜浆料解决方案上,公司进行了长期的自主研发并与TOPCon龙头客户深入合作,进行高铜浆料与种子层浆料联用解决方案的验证与应用实践,已经形成了明显的先发优	
	势。公司目前主要围绕龙	头客户进行战略合作,并形成相应的
投资者关系活	先发优势。后续,将积极:	推动高铜浆料与种子层浆料联用解决
动主要内容介	方案在TOPCon/TBC电池:	组件一体化龙头客户的推广应用。
绍	2. 公司对2025年出生	货量的预期?
	答:光伏导电浆料作	为光伏电池制造的关键原材料, 其市
	场发展跟全球光伏装机量	密切相关。根据不同研究机构预测,
	2025年全球光伏新增装机	仍将持续增长。公司作为光伏导电浆
	料领域的龙头企业,将持续受益于全球光伏装机持续稳健增长	
	的红利,并通过进一步提	升在龙头客户群体中市占率策略,双
	向协同,实现公司稳健发	展。

3. 公司不同类型银浆的加工费情况?

答:相较于前几季度,公司的TOPCon银浆加工费相对稳定,HJT和TBC电池的浆料加工费要高于TOPCon银浆。未来随着TBC/HJT等新电池技术产能的进一步增长,和高铜浆料及其他低银金属化技术创新与产业化发展,对于改善未来公司的盈利能力具有重要积极作用。

4. 公司高铜浆料的相关壁垒?

答:我们认为,未来随着高铜浆料的推出,相应公司产品建立的行业壁垒会更高。从技术上来说,因为高铜浆料技术应用方案本身包括了两种不同类型的浆料的联合使用,各自有技术壁垒的同时,其联合协同使用也有相应的壁垒。从种子层浆料玻璃粉的全新开发设计、银粉体系的重构和形貌调控,到贱金属粉体表面特殊处理和高铜浆料配方增强,以及种子层与高铜层界面适配等,其技术难度会是多维度的提升。从商业上来看,公司目前在含铜浆料的可靠性、出货及市场化推广上处于行业领先位置,结合公司在现有TOPCon、TBC、HJT浆料领域领先的份额、技术地位以及客户结构积累优势,公司将持续积极与客户协同创新,优化市场落地节奏。

5. 高铜浆料量产后的定价模式?

答:随着技术的进步和成本的降低,未来高铜浆料的定价模式将从加工费模式转变为产品定价模式。

6. 高铜浆料与异质结银包铜浆料的成本区别在哪里?

答:高铜浆料的成本要高于异质结银包铜浆料。高铜浆料对于金属粉体可靠性要求更高、技术难度更高,相关金属粉体需要做特殊表面处理、工序更多,同时高铜浆料配方也有专门的可靠性与导电性增强设计,成本结构比异质结银包铜更为复杂、也更高。

7. 公司目前高铜浆料的原材料供应商有哪些?

答:高铜浆料需要使用不同形状和不同尺寸的粉体进行复

配,公司使用的粉体供应商结构目前较为多元。购入相关粉体后,公司会进行独特的表面处理和配方增强,这也是相关浆料产品技术壁垒提升的一部分体现。

8. 公司硝酸银与金属粉体项目进展如何?

答:硝酸银产品的纯度对于金属粉体的性能有重要影响,公司投资建设硝酸银项目与金属粉体项目,可以极大程度地保障供应链安全性与稳定性,并有利于降低原材料成本,构建企业竞争壁垒,提高公司产品竞争力。公司硝酸银项目预计今年上半年建成试投产,金属粉体项目将根据下游客户的需求以及高铜浆料技术的放量趋势来进行规划建设。

9. 公司的外币贷款情况如何?

答: 2024年末,公司外币贷款余额折合成人民币为3.90亿元。公司将继续密切关注国内外政治、经济形势等,与各渠道专业人士交流,择机开展外汇衍生产品交易业务,进行合理的外汇风险管理;同时,公司持续推进国产银粉替代,降低进口银粉采购比例,以减少汇率波动对公司产生的影响。

附件清单(如 有)

无

日期

2025年3月25日